



芯片制造及集成多场跨尺度协同设计方法和技术

刘胜教授 中国科学院院士，武汉大学工业科学研究院执行院长

演讲人简介：

刘胜，武汉大学教授，斯坦福大学博士，ASME Fellow 和 IEEE Fellow，微纳制造领域专家，国内芯片封装技术的引领者，2023 年当选中国科学院院士。刘胜院士在微纳制造科学与工程方面（涉及集成电路、发光二极管 LED、微传感器及电力电子 IGBT 等芯片封装）取得了系统的创新成果。以第一完成人获 2020 年国家科学技术进步一等奖、2016 年国家技术发明二等奖、2015 年教育部技术发明一等奖、2018 年电子学会技术发明一等奖、2009 年 IEEE 国际电子封装学会杰出技术成就奖（全球每年 1 人，国内首人）、2009 年中国电子学会特别成就奖、1997 年国际微电子及封装学会（IMAPS）技术贡献奖、1995 年美国总统教授奖（当年 30 人），1999 年入选首批国家杰青（海外）项目（当年轻 7 人）。发表 SCI 论文 424 篇、SCI 他引 6600 余次，出版专著 6 部（英文 4 部），授权发明专利 196 件。